

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-02

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：
参与单位名称	线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者
时间	2025 年 04 月 29 日 15:00-17:00
地点	线上，价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长 许文焕 总经理 黄效东 财务总监 范长征 董事会秘书 陈国兵 独立董事 张驰亚
投资者关系活动主要内容介绍	1、请问公司在 2024 年的研发投入以及专利情况？ 答：尊敬的投资者您好，2024 年公司及子公司累计投入研发费用 2,768.47 万元，同比增长 4.55%；截至 2024 年末，公司拥有有效授权注册专利 94 项，其中：发明专利 15 项、实用新型专利 70 项，外观设计 9 项；软件著作权登记 56 项；集成电路布图设计权 16 项；PCT10 项。感谢您对公司的关注。 2、公司去年盈利能力下滑的原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年归属上市公司股东的净利润为-11,391.58 万元，较上年同期减少 12,647.15 万元，同比减少 1,007.28%，主要原因系：（1）得益于海外销售的较快增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期均实现两位数增长，持续为公司贡献稳定现金流；（2）报告期内，公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉分别计提了较大金额减值准备，泰博迅睿原股东需对泰博迅睿商誉减值进行补偿，上述因素对公司本报告期净利润产生了较大影响；（3）联营企业广芯微电子与芯微泰克均处于产能爬坡阶段，收入规模较小，且自 2024 年开始计提固定资产折旧费用，因此利润较上年

同期减少；半导体硅片市场 8 英寸以下产品需求复苏不及预期，联营企业晶睿电子外延片销量随着产能提升较上年大幅增长，但销售单价同比下降，且新建产能在爬坡阶段，折旧增加，导致净利润同比上年下滑明显；以上导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减少；（4）全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务市场需求低迷，收入和毛利率同比下降，并计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，导致净利润较上年同期下降明显；（5）受 6 英寸晶圆代工产能迁移影响，功率半导体设计公司广微集成销售收入和净利润较上年同期减少。感谢您对公司的关注。

3、请问未来的发展战略是什么？

答：尊敬的投资者您好，公司未来发展战略为：深耕 AiDC，聚焦功率半导体。AiDC（Artificial Intelligence for Data Capture，应用人工智能进行数据采集）业务，公司将继续以半导体化思维和摩尔定律为指导思想，以客户为中心，不断优化产品结构，针对医疗检测、汽车制造、3C 精密电子等工业应用场景开发功能更全面更高端的新产品，积极开拓工业领域的需求。功率半导体领域，公司将持续打造功率半导体 smart IDM 生态圈，以晶圆代工厂广芯微电子为核心，支持生态圈各环节项目的产能提升和扩产，充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效应。感谢您对公司的关注。

4、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

答：尊敬的投资者您好，2025 年一季度，公司实现营业收入 5,397.90 万元，较上年同期减少 1,170.62 万元，同比减少 17.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,347.10 万元，较上年同期增加 3,326.69 万元，同比增长 16,299.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,770.52 万元，较上年同期减少 1,552.46 万元，同比减少 711.94%。主要原因是：（1）公司于 2025 年 1 月完成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算，公司合并广芯微电子产生了 5,099 万元的税后投资收益，是报告期内归属于上市公司股东的净利润及非经常性损益较上年同期大幅增加的主要原因；同时，因合并广芯微电子，公司新增商誉 15,866 万元。（2）2025 年一季度，广芯微电子产能稳步提升，收入较上年同期有所增长，但项目仍处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，而设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，净利润同比减少；此外，广芯微电子于 2025 年 1 月纳入公司合并报表范围，公司持股比例的增加也对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。感谢您

	对公司的关注。 5、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司未来盈利增长的主要驱动因素包括：（1）功率半导体业务：公司将持续打造功率半导体 smart IDM 生态圈，以晶圆代工厂广芯微电子为核心，支持生态圈各环节项目的产能提升和扩产，充分展现 smart IDM 生态圈的产业链协同效应。（2）AiDC 业务，公司将加大海外业务支持，并依托条码识别领域技术和经验，以 AI+CIS 机器视觉技术平台提供数据采集解决方案，不断优化产品结构，针对工业场景开发更多新产品。感谢您对公司的关注。 6、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，2024 年至今，国内功率半导体行业整体面临价格竞争、库存调整等挑战，终端需求分化明显，传统市场领域面临产品价格下降等压力，汽车电子、AI 算力等新兴市场需求增长明显。感谢您对公司的关注。 7、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，功率半导体是电力电子装置电能转换与电路控制的核心，作为不可替代的基础性产品，被广泛应用于移动通信、消费电子、汽车电子、轨道交通、工业控制、发电与配电等电力电子领域。我国是全球最大的功率半导体消费国，目前占据全球功率半导体市场规模的 37%左右，且功率半导体市场规模仍在逐步增加，预计至 2028 年我国功率半导体市场规模有望达到 405 亿美元。然而，我国功率半导体器件国产化率仍处于相对较低水平，尤其在中高端产品领域国际厂商仍占据较大份额，进口替代市场空间广阔。近年来，经过国家大力的政策扶持和国产厂商努力，国产功率半导体企业发展已取得了长足进步，但与国外品牌企业相比仍存在较大差距，国产功率半导体市场尚未形成稳定的竞争格局。伴随国内功率半导体厂商的不断进步，中国市场有望涌现一批世界级的功率半导体企业。感谢您对公司的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025-04-29